

团 体 标 准

T/CEMIA 027—2022

片式电阻用背电极浆料规范

Specification for back electrode paste for use in chip resistors

2022-02-14 发布

2022-05-15 实施

中国电子材料行业协会 发 布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电子材料行业协会提出并归口。

本文件起草单位：西安宏星电子浆料科技股份有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、国巨电子(中国)有限公司、安徽翔胜科技有限公司。

本文件主要起草人：赵莹、赵科良、梅元、张艳萍、边甄勇、刘姚、鹿宁、吴高鹏、孙社稷、陆冬梅、王大林、李艳、侯聪慧、董金国、莫雪琼、蔡东谋、姜德发、汤华、周勇。

片式电阻用背电极浆料规范

1 范围

本文件规定了片式电阻用背电极浆料的技术要求、检验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存。
本文件适用于由功能相、玻璃相、有机载体以及添加剂组成的能满足印刷特性的片式电阻用背电极浆料(以下简称背电极浆料)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- SJ/T 11512—2015 集成电路用电子浆料性能试验方法
- T/CEMIA 021—2019 厚膜集成电路用电阻浆料规范

3 术语和定义

T/CEMIA 021—2019 界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

方数 square number
浆料烧结膜图形的长宽比,单位符号用“□”表示。
[来源:T/CEMIA 021—2019,3.1]

4 技术要求

4.1 背电极浆料性能应符合表 1 的规定。

表 1 背电极浆料性能

性能	外观	细度 μm	黏度 Pa·s	固体含量 %
低固体含量背电极浆料	色泽均一、无沉淀的膏状体	≤8	100~200	35~55
高固体含量背电极浆料			150~300	55~75
注 1: 黏度在 25℃±1℃、Brookfield 14# 转子、转速 10 r/min 条件下测得。				
注 2: 黏度范围内的具体数值由供需双方协商确定。				

4.2 背电极浆料烧结膜性能应符合表 2 的规定。